

铜箔设备项目沟通清单

适用于阴极辊、阳极槽、溶铜、表面处理机及产线范围沟通。

本清单用于明确电解铜箔设备项目的设备模块范围和基础工艺方向。

1 1. 铜箔产品目标

- 铜箔类型、目标幅宽、厚度范围和产品用途
- 计划产能、线速度、电流密度或生产目标（如已知）
- 新建产线、产线改造、模块替换或技术比选

2 2. 所需设备模块

- 阴极辊直径/幅宽及表面要求
- 阳极槽、铜箔阳极和槽体接口要求
- 溶铜系统、表面处理机、水洗/干燥、收卷或其他模块

3 3. 工艺与公辅

- 电解液方向、添加剂管理、过滤和温控设想
- 公辅条件、土建接口、厂房布局限制和自动化水平
- 期望边界：关键模块、产线集成合作或铜箔设备 EPC 讨论

4 4. 评审资料

- 可提供的布置图、工艺流程、目标规格、既有设备清单或招标文件
- 所需技术方案、模块清单、公开资质文件和沟通截止时间

i 公开范围说明

公开文件仅用于初步沟通。产品配置、技术方案和性能讨论仍需结合已确认的工况、图纸、电解液/水质数据和供货范围。
本文件不包含客户名称、项目图纸、商业条款、涂层配方、铈钽比例或非公开运行数据。